

pcba失效分析，阻燃检测

产品名称	pcba失效分析，阻燃检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

pcba失效分析，阻燃检测

芯片开封Decap Decap即开封，也称开盖，开帽，指给完整封装的IC做局部腐蚀，使得IC可以暴露出来，同时保持芯片功能的完整无损，保持die，bond pads，bond wires乃至lead-frame不受损伤，为下一步芯片失效分析实验做准备，方便观察或做其他测试（如FIB，EMMI），Decap后功能正常。服务范围：芯片开封，环氧树脂去除，IGBT硅胶去除，样品剪薄服务内容：1.IC开封（正面/背面）QFP，QFN，SOT，TO，DIP，BGA，COB等2.样品减薄（陶瓷，金属除外）3.激光打标

无损检测X-Ray X-Ray是利用阴极射线管产生高能电子与金属靶撞击，在撞击过程中，因电子突然减速，其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式观测的位置，利用X-Ray穿透不同密度物质后其光强度的变化，产生的对比效果可形成影像，即可显示出待测物的内部结构，进而可在不破坏待测物的情况下观察待测物内部有问题的区域。